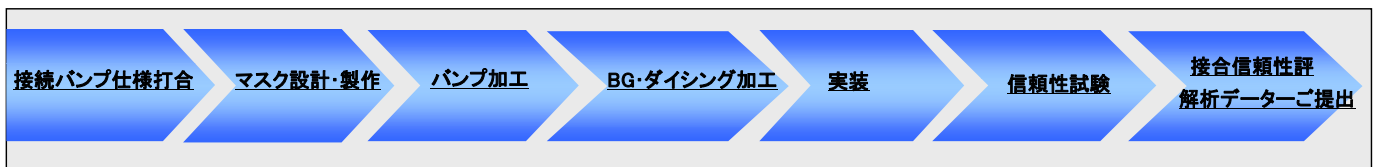


ウェルでは、フリップチップ実装工法開発用TEGチップから、バンプ・再配線加工、各種工法によるフリップチップ実装試作、接続信頼性評価・解析までのターンキー・ソリューションをご提供いたします。

Advanced JISSO Service



実装受託ソリューション・サービスフロー



詳細サービス内容

回路設計受託サービス

- CSPインターポーター基板
- BGA基板
- FPC基板
- COF基板
- COG基板

バンピング・再配線加工サービス

- 電解めっき法 (Au, 半田, Cu, Cu Pillar)
- 再配線加工 (L/S: 10 μm)
- 無電解めっき (Au, UBM)
- スタッドバンプ加工
- ボール搭載

BG・ダイシング加工サービス

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> BG加工 | <input type="checkbox"/> ダイシング加工 |
| <input type="checkbox"/> 4~12インチウエハ対応 | <input type="checkbox"/> ~12インチウエハ対応 |
| <input type="checkbox"/> 30 μm厚まで対応可能 | <input type="checkbox"/> チップサイズ0.3mm対応 |
| <input type="checkbox"/> ストレスリリーフ処理対応 | <input type="checkbox"/> チップトレイ詰め |

フリップチップ実装サービス

- 対応基板: リジット基板、COF、COG
- 熱圧着工法 (ACF実装、NCP)
- C4実装
- 超音波接合 (LED, LCDドライバー、RF、)
- 洗浄 (プラズマ洗浄)

信頼性・接合評価サービス

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> マイグレーション評価 | <input type="checkbox"/> SEM/TEM |
| <input type="checkbox"/> 高温高湿バイアス試験 | <input type="checkbox"/> 断面研磨観察 |
| <input type="checkbox"/> 温度サイクル試験 | <input type="checkbox"/> シェア強度試験 |
| <input type="checkbox"/> 熱抵抗評価 | <input type="checkbox"/> ワイヤー引張強度試験 |
| <input type="checkbox"/> X線観察 | <input type="checkbox"/> 超音波探傷 |

フリップチップ実装装置開発・販売

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 熱圧着フリップチップボンダー | <input type="checkbox"/> LCD端子洗浄機 |
| <input type="checkbox"/> COF・COGフリップチップボンダー | <input type="checkbox"/> FOGアライメント圧着装置 |
| <input type="checkbox"/> 超音波フリップチップボンダー | <input type="checkbox"/> マニュアルブローパー |
| <input type="checkbox"/> ACF自動貼付装置 | <input type="checkbox"/> 微小抵抗測定機 |